

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海通电子、和君咨询、智晶私募、惠璞投资、陆庚资本、聚贝堂投资、天风资管、道子天投资、李子园投资、远海私募、清枫私募、长江六屏私募
时间	2024年11月8日 9:30-11:30;
地点	公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 陈敏；财务总监、董事会秘书 兰芳云；证券事务代表 闵雨琦；证券事务专员 江璐璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节：</p> <p>1、公司在功率半导体领域的技术优势是什么？</p> <p>公司经过多年的技术积累和持续创新，凭借自主核心技术使得芯片产品及应用方案在性能、面积、功耗、兼容性等方面较为先进，公司产品具有高性能、低损耗、低漏电、小型化的特点。同时，公司紧跟客户需求，参与产品定义，与终端工程师深入对接，围绕客户的需求积极开展产品升级迭代与新产品的研发工作。</p> <p>2、请问公司毛利率稳定是如何实现的？</p> <p>公司始终注重维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系，积极推进产品更新迭代；加强供应链的合作及开发，持续优化供应链资源；在有效控制成本的同时，保持合理的定价策略，从而使得产品价格维持在较为稳定的水平，保持整体毛利率稳定。</p> <p>3、公司如何看 IDM 与 Fabless 发展过程中的竞争优</p>

势？

基于经营模式的差别定位，IDM 模式，主营大功率 TVS，工艺简单，直接在衬底做产品，有一定的价格优势，产品型号较稳定。而 Fabless 可以根据市场需求灵活设计，产品更新速度快。公司以高性能、小功率产品为主，在外延方面做设计，因此精度好，减少漏电，适用消费类电子以及工艺要求比较高的应用方面。

4、公司第三代半导体产品有什么新的进展？

公司中低压 GaNHEMT 产品有序开发中，其中 40V 产品已经在客户端进行送样测试。650V Cascode 结构 GaNHEMT 有序开发中，目前初步形成了 50-3000mR 系列产品。

公司 IGBT 产品，650V/1200V100A 以下小电流产品系列化进一步完善，通流能力在 25A~75A 范围，除传统 IGBT 单管外根据市场需求开发 Hybird 产品，采用 TO-247/TO-247PLUS 单管封装形式，目前在工业控制等领域重点推广，部分产品已通过客户试用评测；公司 1200V100A 以上大电流产品持续开发过程，1200V200A 芯片已定型，1200V150A 芯片工程批流片完成正在测试评价。1200V100A、1700V150A/200A 等系列化产品陆续进行流片产出。大电流产品主要采用 Econodual3/62mm 等模块封装形式，重点在新能源领域推广。

5、公司净利润水平比较高，是如何实现的？

公司始终注重维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系，积极推进产品更新迭代；加强供应链的合作及开发，持续优化供应链资源；保持公司整体毛利率稳定。同时，公司一直保持较高的运营效率，有效控制各项费用，综合以上因素使得公司净利率水平较高。

6、请问公司在对外投资方面主要关注的标的方向？

围绕公司战略规划，公司持续关注着与公司技术、产品、

	业务等具有较高协同性的优质资源，以及与汽车电子、风光储充等应用领域相关的标的。公司将积极挖掘投资并购机会，有效整合上下游资源，进一步优化公司产业布局。
附件清单（如有）	
日期	2024年11月8日